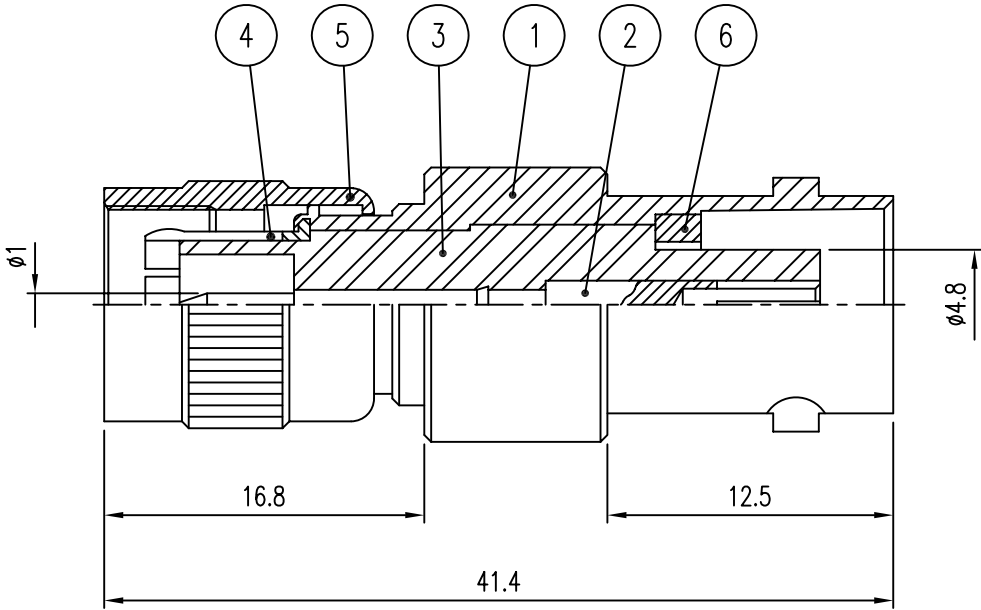


1		2										3				4			
	기공 ST											수 정 내 용							
											부호	내 용		수정자	승인자	년 월 일			
	ST(기준)										△								
	ST(개선)										△								



6	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00055-15/1 (L6006)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00085-135/1 (K5002)
4	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00065-135/1 (J5001)
3	INSULATOR	1	SILICON		DAI00033-N/1 (HA054)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00053-1345/1 (EA040)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00049-135/1 (DA046)

대체가능재질		품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05		년월일 2000. 8. 18.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
		승인						
재질 _____		검도				도명 BNCJ-1.6/5.6P		
		재도						
열처리 _____		작성부서 연 구 소				A4	도번 AD00122-7/1 K361-592-000	
보호피막처리 _____								
		척도 NS	단위 mm	중량 _____				